

## BUNGARD SPLASH CENTER MACCHINA PER INCISIONE E SVILUPPO PCB



Cod. 540144B



### SPLASH CENTER - INCISIONE E SVILUPPO CIRCUITI STAMPATI

Bungard Splash Center è una **macchina manuale professionale per l'incisione e lo sviluppo di PCB dotata di 5 vasche** con rulli per asciugatura meccanica.

Unità completa pensata per garantire condizioni ottimali di pulizia ed ergonomia nei processi di incisione e risciacquo, adatta per la lavorazione di **schede mono e doppia faccia**.

Il tipico flusso di lavoro con metodo di **fotoincisione positiva\*** prevede di utilizzare la vasca 1 per incisione verticale spray, le vasche 2 e 3 per risciacquo, la vasca 4 (dotata di pompa centrifuga) per sviluppo e la vasca 5 di riserva per stagnatura o per pulitura.

### CARATTERISTICHE

#### Area incisione\*

- Sistema semplice da mantenere con solidi ugelli per incisione a spruzzo verticale
- **Velocità di incisione (cloruro ferrico, tiepido): 35 µm su rame entro 90 secondi**



- **Dimensione max. schede lavorabili: 210 x 300 mm** (300 x 400 mm con Splash-Center XL: disponibile su richiesta)
- **Definizione piste: (migliore di) 0.1 mm (100 µm)**
- Idonea per i liquidi di incisione comunemente utilizzati (si raccomanda comunque l'utilizzo di cloruro ferrico)
- Ampia finestra in PVC trasparente sulla camera di incisione
- Facile accesso alla camera di incisione (il coperchio è dotato di interruttore di sicurezza)
- Il portaschede removibile in titanio e PVC può essere bloccato in posizione verticale, consentendo una prima asciugatura della scheda da risciacquare
- Riscaldatore al quarzo 1000W - Temperatura di incisione controllata termostaticamente
- Timer digitale con auto-reset e allarme acustico
- La vasca per incisione è adatta anche per sviluppo a spruzzo\*.

#### Area sviluppo e risciacquo

- **Vasca di sviluppo** con pompa centrifuga magnetica\*
- **Vasca per risciacquo statico**
- **Vasca di risciacquo con acqua fredda a spruzzo** attivato da interruttore a pedale con protezione dagli schizzi (può essere utilizzata anche per risciacquo statico)
- **Vasca di riserva** (utilizzabile ad esempio per stagnatura chimica).

#### Altre specifiche

- Alimentazione: 220V, 50Hz, 1.5kW ca.
- **Capacità della vasca per incisione: 25L**
- **Capacità delle vasche statiche: 1 x 9L, 3 x 7L**
- Ogni vasca è fornita con coperchio
- Lo scarico delle vasche è regolato da 5 valvole a sfera facilmente accessibili dall'operatore
- Asciugatura meccanica con rulli integrata
- Vassoio antigocciolamento per tutte le vasche, assicurato a 120mm di altezza da terra
- Dimensioni esterne: 100 x 67 H120 cm.

#### \* PRECISAZIONI TECNICHE:

La vasca per sviluppo con pompa centrifuga è **adatta per la lavorazione di schede con photoresist positivo con uno spessore di 3-5 µm**. Chi utilizza la fotoincisione positiva avrà così a disposizione tutti i processi in un'unica macchina.

Con le schede con **photoresist negativo** invece, a causa dello spessore del materiale (35 µm), si consiglia di eseguire lo sviluppo nella prima vasca a spruzzo verticale, in modo da ottenere una migliore definizione.

Quindi Bungard Splash Center può essere utilizzato anche per lo sviluppo a spruzzo verticale di photoresist negativo, anche se in questo caso solitamente si utilizzano due macchine diverse: una Splash per sviluppo (disponibile su richiesta) e uno Splash Center per l'incisione.

Guarda tutti gli articoli disponibili: **[Macchine per la produzione di circuiti stampati](#)**